

大阪PCB処理事業所プラント設備の解体撤去について

大阪PCB処理事業所では、本格的な解体撤去を行う場所を確保するため、**図-1**大阪PCB処理事業所設備解体撤去の流れ（案）のとおり、令和3年度から「JESCO PCB廃棄物処理施設解体撤去実施マニュアル共通編」（以下、「共通マニュアル」という。）に基づき施設の解体撤去の準備に着手しており、令和4年度に小型解体室の一部装置、機器類について解体撤去を実施し、令和5年度には小型解体室に残存している装置、機器類の解体撤去を、令和6年度からは大型解体室の装置、機器類の解体撤去工事を実施する予定です。併せて、本格的な解体撤去に向け、今後使用しない配管やタンク等の解体前循環洗浄等を行いPCBの分別除去を順次進めてまいります。

年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8
計画的処理完了期限	▶		▶			
事業終了準備期間	▶					
PCB 付着状況調査	小型解体室 その1 約40t →	小型解体室 その2 約70t →	大型解体室 約225t分 →			
解体撤去の準備	小型解体室 解体撤去工事 その1 約40t →		小型解体室 解体撤去工事 その2 約70t →	大型解体室 解体撤去工事 約225t分 →		
プラント設備のPCB除去分別		-----		液抜き・解体前循環洗浄等 →		
本格的なプラント設備解体撤去工事						プラント設備 解体撤去工事 残り約6,100t →

図-1 大阪PCB処理事業所設備解体撤去の流れ（案）

※プラント設備の解体撤去後に建屋の除去分別、建物の解体撤去を実施します。なお、解体撤去の流れは大まかな工程であり、今後工法・工期等を詳細に検討します。

1. 小型解体室解体撤去工事その2対象機器と小型解体室の床・壁及びダクトのPCB付着状況について

令和5年度に実施します小型解体室解体撤去工事その2の小型車載型トランス用容器解体装置等8基の対象機器及び当該装置周辺機器及び架台のPCB付着状況調査を別紙1のとおり実施しており、1点130 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ を最大にそれ以外は1～63 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ であり、いずれも低濃度PCB付着レベルであり解体工事着手基準200 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ （令和3年11月 弊社「共通マニュアル」）を下回っています。

併せて、小型解体室の床、壁及びダクトのPCB付着状況調査も実施しました。

床については、装置等設置されていないところで、小型解体室全域から7カ所サンプリングして1.4～55 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ 、壁についても同様に小型解体室内の各壁面において、床から50cmの高さを基本に1mを2カ所、1.3mを1カ所計7カ所サンプリングして0.87～6.4 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ 、またダクトについては4カ所サンプリングして13～100 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ といずれも低いPCB濃度でした。

こうした結果を踏まえ、予定どおり令和5年度から小型解体室解体撤去工事その2の契約手続きを進め、令和5年11月に工事着手を行いたいと考えています。